

Hilmar Beine

Solide aufgestellt

Auch am Pionier für die Bestückung von elektronischen Bauelementen ist die weltweite Flaute nicht spurlos vorübergegangen. Allerdings hat man, ohne viel darüber zu reden, vor allem im Hochgeschwindigkeitsbereich gute Geschäfte gemacht. Andererseits kommen gerade jetzt jede Menge neue Modelle, inzwischen auch schon in Asien gefertigt, auf den Markt, die besonders die Mittelklasse bedienen sollen.

Jede Menge neue Modelle wird Universal Instruments in diesem Jahr Vorstellen. „Der Grund liegt vielleicht auch darin, dass wir in den mageren Zeiten unsere Chance genutzt haben, verstärkt an der Entwicklung neuer Maschinenkonzepte zu arbeiten,“ erläutert Gene A. Heiser (**Bild 1**), Senior Vice President der Universal Instruments Corporation. „Und wir wollen natürlich zu dem Zeitpunkt, wo die Konjunktur wieder aufwärts strebt optimal vorbereitet sein. Unsere Aktivitäten in Konsortien und innerhalb bestimmter Zukunftsprojekte sind allemal ohne Abstriche weitergelaufen. Unsere F & E-Abteilung und unser Applikationslabor in Binghampton, NY, unserem Hauptsitz, hat sich gerade in letzter Zeit besonders auf die Fertigstellung serienreifer Technologien konzentriert und in diesem Jahr werden wir die Ergebnisse geballt vorstellen.“

Global gesehen hat sich Universal Instruments inzwischen weiter konsolidiert. Im Februar hat UIC die Eröffnung einer Maschinenfertigung in Shekou, Guandong, China gefeiert. Hier sind rund 5 Mio. US \$ in eine Montage von GSM-Maschinen investiert worden. Die Muttergesellschaft Dover, zu der auch Vitronics-Soltec und DEK gehören, hat in den Kauf der Hoover Davis investiert, einem Spezialisten für High-Tech-Komponentenzuführungen, wie sie auf Universal Instruments-



Bild 1: Gene A. Heiser, Senior Vice President der Universal Instruments Corporation



Bild 2: Jörg Pieper, Director of European Operations, der Universal Instruments Europe

Maschinen schon länger einsetzbar sind. Auch Hoover Davis plant übrigens eine Fertigung in China.

In Europa bleibt alles beim alten, zumindest was die Mannschaften angeht. In Bad Vilbel stehen die 30 Mitarbeiter bei Fuß. Von hier aus wird die Ersatzteilversorgung für Europa organisiert, der Vertrieb geschult und Kundentrainings durchgeführt. Was sonst noch europäische Belange angeht, 15 Mitarbeiter sind es in der französischen Niederlassung und auch in UK, in Spanien, in Italien, Benelux und in Schweden hat man seine eigenen Offices beibehalten. In Ungarn agiert eine weitere Niederlassung erfolgreich für ganz Osteuropa.

„Und nach wie vor gibt es in diesen Niederlassungen eine Menge zu tun – natürlich nicht so viel wie im Jahr 2000,“ erklärt Jörg Pieper (**Bild 2**), Director of European Operations der Universal Instruments Europe.

„Wir waren in Europa in letzter Zeit vor allem mit Hochgeschwindigkeitslösungen involviert. Mit dem Produktportfolio, was bis dato angeboten werden kann und konnte, sind wir und vor allem unsere Anwender recht gut voran gekommen. Wir konnten z.B. erfolgreich unsere Polaris-Bestücker (**Bild 3**) vermarkten. Zusammen mit Asys, unserem Partner in Sachen Boardhandling in Mitteleuropa, konnten wir einige interessante End-of-Line-Projekte abschließen. Mit den Produkten die in diesem Jahr dazu kommen, können wir unsere Bemühungen noch besser transportieren. Da ist die Hochgeschwindigkeitsmaschine 4797L und im Sommer wird es mit Vantis einiges im Mittelklassebereich geben.“



Chipshooter für große Boards

Die 4797L ist speziell für die Verarbeitung großer Boards entwickelt, bringt aber die gleichen Leistungsdaten der heutigen Chipshooter-Modelle 4797A und 4797S HSP. Merkmal der Serie 4797 ist ein ‚schlankes‘ Design mit weniger mechanischen Teilen. Damit sind diese Maschinen zuverlässiger und einfacher zu bedienen und zu warten. Mit einer maximalen Leiterplattengröße von 457 mm x 610 mm bietet sich die Maschine für die meisten Großformat-Bestückungsaufgaben an.

Die wesentlichen Verbesserungen des Chipshooters 4797L gegenüber dem früheren Großformat-Bestücker sind



Bild 3: Der Bestückungskopf des Polaris-Exotenbestücker

- ▶ die Größe der Boards bis zu 457 mm x 610 mm,
- ▶ bei einem Bestückungsbereich von 457 mm x 585 mm, gegenüber der maximalen Größe des Boards und des bestückbaren Bereichs von 457 mm x 508 mm beim Vorgängermodell,
- ▶ 33% höhere Bestückungsgeschwindigkeit mit einem Maximum von 48 000 BE/h gegenüber 36 000 BE/h,
- ▶ größere Komponentenpalette von 0201 bis zu 26 mm² QFPs sowie Area-Array-Packages,
- ▶ weiterentwickelte Direktantriebs-Köpfe für höheren Durchsatz und verbesserte Positioniergenauigkeit und
- ▶ Zuführmodule mit Linearmotorantrieb für höhere Genauigkeit bei der Komponentenaufnahme.



Bild 4: Eine GSM mit Flexjet-Kopf

„Dank dieser Erweiterungen sowie der Verbesserungen der optischen Inspektion und der schnelleren Komponenten-Feeder bietet die 4797L Höchstleistungen bei der Bestückung großer Leiterplatten“, sagt Heinz Dommel, HSP-Product-Manager bei Universal Instruments. „Daraus resultieren höherer Durchsatz, bessere Maschinennutzung und höhere Produktivität.“

Der HSP Chipshooter 4797L ergänzt die bestehende Serie 4797 der High-Speed-Bestücker, mit der 4797A in Standardgröße und der 4797S mit kleiner Stellfläche. Alle Universal HSP-Maschinen nutzen die Technik des Direktantriebs und erlauben damit die Theta-Korrektur on-the-fly für schnellere Bestückung großer Bauteile.

Fax +49/61 01/80 82 22

www.uic.com

productronic **418**